#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-188347

(43)Date of publication of application: 10.07.2001

(51)Int.CI.

GO3F 7/039 CO8K 5/00 CO8L 33/14 CO8L 45/00 H01L 21/027

(21)Application number: 2000-137757

(71)Applicant:

**JSR CORP** 

(22)Date of filing:

10.05.2000

(72)Inventor:

ISHII HIROYUKI

**DOUKI KATSUJI** 

**KAJITA TORU** 

SHIMOKAWA TSUTOMU

(30)Priority

Priority number: 11296028

Priority date : 18,10,1999

Priority country: JP

#### (54) RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOSITION

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radiation sensitive resin composition excellent in shelf stability, having high transparency to radiation and excellent also in basic physical properties as a resist such as dry etching resistance, sensitivity, resolution and pattern shape.

SOLUTION: The radiation sensitive resin composition contains (A) an acid- dissociable group-containing resin having repeating units derived from a (meth) acrylic acid derivative having an alicyclic skeleton containing an oxygen- or nitrogen-containing polar group typified by 3-hydroxy-1-adamantyl (meth)acrylate or 3-(8'-cyanotetracyclo[4.4.0.12,5.17,10]dodecyl (meth)acrylate and repeating units derived from another (meth)acrylic acid derivative having an alicyclic skeleton typified by 2-methyl-2adamantyl (meth)acrylate and convertible to an alkali- soluble resin when the acid-dissociable group is dissociated and (B) a radiation sensitive acid generating agent.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-188347 (P2001-188347A)

(43)公開日 平成13年7月10日(2001.7.10)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
G03F 7/039	601	G 0 3 F 7/039	601 2H025
C08K 5/00		C08K 5/00	4 J 0 0 2
CO8L 33/14		C08L 33/14	
45/00		45/00	
H01L 21/027		H01L 21/30	502R
		審査請求 未請求 請	情求項の数3 OL (全 36 頁)
(21)出顧番号	特顧2000-137757(P2000-137757)	(71)出顧人 000004178	
(22)出顧日	平成12年5月10日(2000.5.10)	東京都中央	スアール株式会社 や区築地2丁目11番24号
		(72)発明者 石井 寛之	<u> </u>
(31)優先権主張番号	特願平11-296028	東京都中央	や区築地二丁目11番24号 ジェイ
(32)優先日	平成11年10月18日(1999.10.18)	エスアール	ル株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 銅木 克》	***
		東京都中央	や区築地二丁目11番24号 ジェイ
		エスアール	レ株式会社内
		(74)代理人 100100985	
		弁理士 名	国沢 俊明

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

# (57)【要約】

線に対する透明性が高く、しかもドライエッチング耐性、感度、解像度、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れた感放射線性樹脂組成物を提供する。 【解決手段】 感放射線性樹脂組成物は、(A)3-ヒドロキシー1-アダマンチル(メタ)アクリレート、3-(8'-シアノテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2.5}$ .1 $^{2.10}$ ]ドデシル)(メタ)アクリレート等で代表される酸素含有極性基または窒素含有極性基を含有する脂環式骨格を有する(メタ)アクリル酸誘導体に由来する繰返し単位と、2-メチルー2-アダマンチル(メタ)アクリレート等で代表される脂環式骨格を有する他の(メタ)アクリル酸誘導体に由来する繰返し単位とを有する酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶性となる樹脂、並びに(B)感放射線性酸発生剤を含有する。

【課題】 組成物としての保存安定性が優れ、かつ放射

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)下記一般式(1)で表される繰返し単位および下記一般式(2)で表される繰返し単位を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶性となる樹脂、並びに(B)感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。【化1】

$$\begin{array}{c}
R^1 \\
C - CH_2 - \\
O = C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^2
\end{array}$$
(1)

【一般式(1)において、R<sup>1</sup>は水素原子、炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシアルキル基を示し、Aは単結合または主鎖炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基を示し、R<sup>2</sup>は下記式

(i)(但し、R³は炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基を示し、X¹は1価の酸素含有極性基または1価の窒素含有極性基を示す。)、式(ii)(但し、R¹は炭素数4~20の3価の脂環式炭化水素基を示し、X³は2価の酸素含有極性基または2価の窒素含有極性基を示す。)または式(iii)(但し、R³は炭素数4~20の4価の脂環式炭化水素基を示し、X³は3価の酸素含有極性基または3価の窒素含有極性基を示す。)

【化2】

で表される基を示す。〕

【化3】

【一般式(2)において、 $R^6$  は水素原子、炭素数 $1\sim$ 4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数 $1\sim$ 4の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基または炭素数 $1\sim$ 4の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシアルキル基を示し、 $R^7$  は炭素数 $4\sim$ 20の1 価の脂環式炭化水素基または下記式(iv)

【化4】

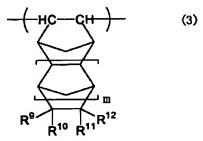
(但し、各R。は相互に独立に炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基を示し、かつ少なくとも1つのR。が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基で10 あるか、あるいは何れか2つのR。が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基を形成し、残りのR。が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基である。)で表される基を示す。〕

【請求項2】 (A)成分における一般式(1)で表される繰返し単位中のR'、R'およびR'の各脂環式炭化水素基並びに一般式(2)で表される繰返し単位中のR'の1価の脂環式炭化水素基およびR'の1価もしくは2価の脂環式炭化水素基が相互に独立に、アダマンタン骨格、ノルボルナン骨格、トリシクロデカン骨格およびテトラシクロドデカン骨格の群から選ばれる脂環式骨格を有する基であることを特徴とする請求項1記載の感放射性樹脂組成物。

【請求項3】 (A)成分が一般式(1)で表される繰返し単位、一般式(2)で表される繰返し単位および下記一般式(3)で表される繰返し単位を有することを特徴とする請求項1または請求項2記載の感放射線性樹脂組成物。

【化5】

30



(一般式(3)において、R°、R¹¹、R¹¹およびR¹²は相互に独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは非置換の炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、置換もしくは非置換の直鎖状もしくは分岐状の炭素数1~6のアルコキシル基または炭素数2~20の酸解離性基を示し、mは0、1または2の整数である。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組成物に関わり、さらに詳しくは、KrFエキシマレーザーあるいはArFエキシマレーザー等の遠紫外線、シン50 クロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如

き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型 レジストとして好適に使用することができる感放射線性 樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加 工の分野においては、より高い集積度を得るために、最 近では0.20μm以下のレベルでの微細加工技術が必 要になるとされている。従来のリソグラフィープロセス においては、一般に放射線として i 線等の近紫外線が用 いられているが、近紫外線ではサブクオーターミクロン 以下のレベルでの微細加工が極めて困難であると言われ ている。そこで、0.20μm以下のレベルにおける微 細加工を可能とするために、より波長の短い放射線の利 用が検討されている。このような短波長の放射線として は、例えば、水銀灯の輝線スペクトルやエキシマレーザ ーに代表される遠紫外線、X線、電子線等を挙げること ができるが、これらのうち、特にKFFエキシマレーザ - (波長248nm) あるいはArFエキシマレーザー (波長193nm)が注目されている。前記短波長の放 射線に適した感放射線性樹脂組成物として、酸解離性官 20 能基を有する成分と放射線の照射(以下、「露光」とい う。) により酸を発生する感放射線性酸発生剤との間に おける化学増幅効果を利用した組成物(以下、「化学増 幅型感放射線性組成物」という。)が数多く提案されて いる。このような化学増幅型感放射線性組成物として は、例えば、特公平2-27660号公報に、カルボン 酸の t - ブチルエステル基またはフェノールの t - ブチ ルカーボナート基を有する重合体と感放射線性酸発生剤 とを含有する組成物が提案されている。この組成物は、 露光により発生した酸の作用により、重合体中に存在す るtーブチルエステル基やtーブチルカーボナート基が 解離して、該重合体がカルボキシル基あるいはフェノー ル性水酸基からなる酸性基を有するようになり、その結 果、レジスト被膜の露光領域がアルカリ現像液に易溶性 となる現象を利用したものである。ところで、従来の化 学増幅型感放射線性組成物の多くは、フェノール系樹脂 をベースにするものであるが、このような樹脂の場合、 放射線として遠紫外線を使用する場合、樹脂中の芳香族 環に起因して遠紫外線が吸収されるため、露光された遠 紫外線がレジスト被膜の下層部まで十分に到達できない という欠点があり、そのため露光量がレジスト被膜の上 層部では多く、下層部では少なくなり、現像後のレジス トパターンが上部が細く下部にいくほど太い台形状にな ってしまい、十分な解像度が得られないなどの問題があ った。また現像後のレジストパターンが台形状となった 場合、次の工程、即ちエッチングやイオンの打ち込みな どを行う際に、所望の寸法精度が達成できず、問題とな っていた。しかもレジストバターン上部の形状が矩形で ないと、ドライエッチングによるレジストの消失速度が 速くなってしまい、エッチング条件の制御が困難になる 50

問題もあった。

【0003】一方、レジストパターンの形状は、レジス ト被膜の放射線透過率を高めることにより改善すること ができる。例えば、ポリメチルメタクリレートに代表さ れる(メタ)アクリレート系樹脂は、遠紫外線に対して も透明性が高く、放射線透過率の観点から非常に好まし い樹脂であり、例えば特開平4-226461号公報に は、メタクリレート系樹脂を使用した化学増幅型感放射 線性組成物が提案されている。しかしながら、この組成 物は、微細加工性能の点では優れているものの、芳香族 環をもたないため、ドライエッチング耐性が低いという 欠点があり、この場合も高精度のエッチング加工を行う ことが困難であり、放射線に対する透明性とドライエッ チング耐性とを兼ね備えたもとのは言えない。また、化 学増幅型感放射線性組成物からなるレジストについて、 放射線に対する透明性を損なわないで、ドライエッチン グ耐性を改善する方策の一つとして、組成物中の樹脂成 分に、芳香族環に代えて脂環族環を導入する方法が知ら れており、例えば特開平7-234511号公報には、 脂環族環を有する(メタ)アクリレート系樹脂を使用し た化学増幅型感放射線性組成物が提案されている。しか しながら、従来の脂環族環を導入した化学増幅型感放射 線性組成物では、酸解離性官能基として、酸により比較 的解離し易い基(例えば、テトラヒドロピラニル基等の アセタール系官能基)あるいは酸により比較的解離し難 い基(例えば、t-ブチルエステル基やt-ブチルカー ボネート基等の t - ブチル系官能基) が一般に用いられ ており、前者の酸解離性官能基を有する樹脂成分を用い る場合、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状 は良好であるが、組成物としての保存安定性に難点があ り、また後者の酸解離性官能基を有する樹脂成分を用い る場合は、逆に保存安定性は良好であるが、レジストの 基本物性、特に感度やパターン形状が損なわれるという 欠点がある。しかも、これらの組成物は、樹脂成分が脂 環族環を有するため、樹脂自体の疎水性が非常に高くな り、基板接着性についても問題があった。そこで、放射 線に対する透明性が高く、しかも保存安定性、ドライエ ッチング耐性、感度、解像度、パターン形状等に優れ、 また基板接着性も良好な化学増幅型感放射線性組成物の 開発が求められている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、活性放射線、例えば、KrFエキシマレーザーあるいはArFエキシマレーザーに代表される遠紫外線、に感応する化学増幅型レジストとして、組成物としての保存安定性が優れ、かつ放射線に対する透明性が高く、しかもドライエッチング耐性、感度、解像度、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れた感放射線性樹脂組成物を提供することにある。

0005]

(4)

10

【課題を解決するための手段】本発明によると、前記課 題は、(A)下記一般式(1)で表される繰返し単位

(1) および下記一般式(2) で表される繰返し単位

(II) を有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の 酸解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離した ときアルカリ可溶性となる樹脂、並びに(B)感放射線 性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂 組成物。

[0006]

【化6】

【0007】 [一般式(1) において、R1 は水素原 子、炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル 基、炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシ ル基または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のヒド ロキシアルキル基を示し、Aは単結合または主鎖炭素数 1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基を示し、 R'は下記式(i)(但し、R'は炭素数4~20の2 価の脂環式炭化水素基を示し、X1 は1価の酸素含有極 性基または1価の窒素含有極性基を示す。)、式(ii) (但し、R1は炭素数4~20の3価の脂環式炭化水素 基を示し、X<sup>2</sup> は2価の酸素含有極性基または2価の窒 素含有極性基を示す。) または式(iji)(但し、R'は 炭素数4~20の4価の脂環式炭化水素基を示し、X3 は3価の酸素含有極性基または3価の窒素含有極性基を 示す。)

[0008]

【化7】

【0009】で表される基を示す。〕

[0010]

[化8]

【0011】 [一般式(2) において、R° は水素原

子、炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル 基、炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシ ル基または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のヒド ロキシアルキル基を示し、R'は炭素数4~20の1価 の脂環式炭化水素基または下記式(iv)

[0012] [化9]

【0013】(但し、各R®は相互に独立に炭素数1~ 4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4 ~20の1価の脂環式炭化水素基を示し、かつ少なくと も1つのR®が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状の アルキル基であるか、あるいは何れか2つのR®が相互 に結合して、それぞれが結合している炭素原子とともに 炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基を形成し、残 りのR°が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアル キル基である。)で表される基を示す。) により達成さ

【0014】以下、本発明を詳細に説明する。

## (A)成分

本発明における(A)成分は、前記一般式(1)で表さ れる繰返し単位(以下、「繰返し単位(1)」とい う。) および前記一般式(2) で表される繰返し単位 (以下、「繰返し単位(2)」という。)」を必須の構 成単位とするアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸 解離性基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したと きアルカリ可溶性となる樹脂(以下、「樹脂(A)」と いう。) からなる。樹脂(A) における繰返し単位 (1) および繰返し単位(2) は、それらのカルボン酸 エステル基が酸解離性を有し、後述する酸発生剤(B) から発生した酸の作用により解離してカルボキシル基を 形成することにより、樹脂(A)をアルカリ可溶性とす る作用を示す単位である。本発明においては、樹脂

(A)を含有することにより、レジストとして、特に放 射線に対する透明性およびドライエッチング耐性が優れ た感放射線性樹脂組成物を得ることができる。 40 【0015】一般式(1)において、R'の炭素数1~

4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例え ば、メチル基、エチル基、n-プロビル基、i-プロビ ル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチ ルプロピル基、t-ブチル基等を挙げることができる。 また、R<sup>1</sup> の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のア ルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ 基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキ シ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ 基、t-ブトキシ基等を挙げることができる。また、R

50 1 の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシ

アルキル基としては、例えば、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエチル基、1ーヒドロキシプロビル基、3ーヒドロキシプロビル基、3ーヒドロキシブロビル基、2ーヒドロキシブチル基、4ーヒドロキシブチル基等を挙げることができる。これらのR<sup>1</sup>のうち、特に、水素原子、メチル基、ヒドロキシメチル基等が好ましい。

【0016】一般式(1)において、Aの主鎖炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基としては、例えば、メチレン基、エチレン基、1-メチル-1,1-エチレン基、プロピレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基等を挙げることができる。これらのアルキレン基のうち、特に、メチレン基が好ましい。

【0017】一般式(1)において、R'、R'および R'の炭素数4~20の各脂環式炭化水素基としては、 例えば、アダマンタン骨格、ノルボルナン骨格、トリシ クロデカン骨格、テトラシクロドデカン骨格や、シクロ ブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘブ タン、シクロオクタン等のシクロアルカン骨格を有する 20 基; これらの基を、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチ ルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等 の炭素数1~10の直鎖状、分岐状または環状のアルキ ル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等の脂環 式骨格を有する基等を挙げることができる。これらの脂 環式炭化水素基のうち、アダマンタン骨格、ノルボルナ ン骨格、トリシクロデカン骨格およびテトラシクロドデ カン骨格の群から選ばれる脂環式骨格を有する基や、と れらの基を前記直鎖状、分岐状または環状のアルキル基 30 で置換した基等が好ましく、特に、アダマンタン骨格、 ノルボルナン骨格、トリシクロデカン骨格およびテトラ シクロドデカン骨格の群から選ばれる脂環式骨格を有す る基や、これらの基をメチル基あるいはエチル基で置換 した基等が好ましい。

【0018】一般式(1)において、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup> および X<sup>3</sup>のうち、酸素含有極性基としては、例えば、ヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、= O基);アルド基(即ち、- CHO基);ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル 40基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシブチル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロ

キシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、nープロボキシ基、iープロボキシ基、nープトキシ基、2ーメチルプロボキシ基、1ーメチルプロボキシ基、tープトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシル基等を挙げることができ、また窒素含有極性基としては、例えば、シアノ基;シアノメチル基、2ーシアノエチル基、3ーシアノプロビル基、4ーシアノブチル基等の炭素数2~5のシアノアルキル基等を挙げることができる。これらの酸素含有極性基および窒素含有極性基のうち、特に、ヒドロキシル基、オキシ基、アルド基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル基等が好ましい。

【0019】繰返し単位(1)を与える単量体としては、例えば、下記一般式(4)で表される(メタ)アクリル酸誘導体(以下「(メタ)アクリル酸誘導体(4)」という。)を挙げることができる。

[0020]

(5)

【化10】

$$\begin{array}{ccc}
R^{1} \\
C = CH_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
A \\
R^{2}
\end{array}$$

【一般式(4) において、 $R^1$ 、 $R^2$  およびAは一般式(1) のそれぞれ $R^1$ 、 $R^2$  およびAと同義である。)【0021】(メタ) アクリル酸誘導体(4) の具体例としては、下記式(4-1)  $\sim$  (4-127)で表される化合物等を挙げることができる。

[0022]

【化11】

$$H_2C = CH$$
  $H_2C = CH$   $H_2C = CH$   $H_2C = CH$   $H_2C = CH$   $C =$ 

[0023] [化12]

(8)

СНО

Ж

# [0035]

# [0036]

$$H_2C = CH$$
 $H_2C = CH$ 
 $H_2C$ 

[0037]

[0038]

【化27】

17
$$H_{2}C = CH \qquad H_{2}C = C \qquad H_{3}C - C - CH_{3} \qquad HO \qquad HO \qquad HO$$

$$(4-65) \qquad (4-66) \qquad (4-67) \qquad (4-68) \qquad * \qquad * \qquad (4L 2 8 ) \qquad CH_{3}$$

$$H_{2}C = CH \qquad H_{2}C = CH \qquad$$

[0040] 【化31】 【化29】

(4-79) (4-81) (4-82) (4-80)

[0043]

40

[0041] [(£30] (4-77)

(4-76)

(4-75)

[0044] [0042] [化33] 50

(4-78)

(4-87)

(4-88)

(4-90)

[0045]

[0046] 【化35】

**%**[0047] 【化36】

ж

30

[0048]

【化37】

[0051]

[0053]

$$H_2C=CH$$
 $H_2C=CH$ 
 $C=CH$ 
 $C$ 

(4-122) (4-123) (4-124) (4-125)

[0054] 【化43]

(4-126) (4-127)

【0055】 これらの(メタ)アクリル酸誘導体(4)のうち、特に、式(4-1)、式(4-2)、式(4-4)、式(4-5)、式(4-7)、式(4-9)、式(4-12)、式(4-14)、式(4-28)または式(4-35)で表される化合物等が好ましい。樹脂(A)において、繰返し単位(4)は、単独でまたは2種以上が存在することができる。

【0056】樹脂(A)において、繰返し単位(1)の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、5~85モル%、好ましくは10~80モル%、さらに好ましくは15~70モル%である。この場合、繰返し単位(1)の含有率が5モル%未満では、得られるレジストの基板への接着性が低下する傾向があり、一方、85モル%を超えると、レジストとしての現像性が低下する傾向があ

る。

\* (化42)

【0057】次に、一般式(2)において、R<sup>6</sup>の炭素 数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基として は、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i -プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、 1-メチルプロピル基、t-ブチル基等を挙げることが 30 できる。また、R°の炭素数1~4の直鎖状もしくは分 岐状のアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、 エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n -ブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプ ロポキシ基、t-ブトキシ基等を挙げることができる。 また、R°の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のヒ ドロキシアルキル基としては、例えば、ヒドロキシメチ ル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル 基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピ ル基、3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシブチ ル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル 基、4-ヒドロキシブチル基等を挙げることができる。 これらのR°のうち、特に、水素原子、メチル基等が好 ましい。

【0058】一般式(2)において、R'およびR'の 炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基並びに2つの R'が相互に結合して形成した炭素数4~20の2価の 脂環式炭化水素基としては、例えば、アダマンタン骨 格、ノルボルナン骨格、トリシクロデカン骨格、テトラ シクロドデカン骨格や、シクロブタン、シクロベンタ ン、シクロヘキサン、シクロヘブタン、シクロオクタン 等のシクロアルカン骨格を有する基; これらの基を、例 えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロ ピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メ チルプロピル基、t-ブチル基等の炭素数1~10の直 鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるい は1個以上で置換した基等の脂環式骨格を有する基を挙 げることができる。これらの脂環式炭化水素基のうち、 特に、アダマンタン骨格、ノルボルナン骨格、トリシク ロデカン骨格およびテトラシクロドデカン骨格の群から 選ばれる脂環式骨格を有する基や、これらの基を前記直 10 鎖状、分岐状または環状のアルキル基で置換した基等が 好ましく、特に、アダマンタン骨格、ノルボルナン骨 格、トリシクロデカン骨格およびテトラシクロドデカン 骨格の群から選ばれる脂環式骨格を有する基や、これら の基をメチル基あるいはエチル基で置換した基等が好ま LULA

25

【0059】また、R®の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t 20-ブチル基等を挙げることができる。これらのアルキル基のうち、特に、メチル基、エチル基等が好ましい。【0060】さらに、一般式(2)における式(iv)で表される基としては、何れか2つのR®が相互に結合して、炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基、好まし\*

\*くはアダマンタン骨格、ノルボルナン骨格、トリシクロ デカン骨格およびテトラシクロドデカン骨格の群から選 ばれる脂環式骨格を有する基並びにこれらの基をメチル 基あるいはエチル基で置換した基の群から選ばれる基を 形成し、残りのR®が炭素数1~4の鎖状アルキル基で ある基が望ましい。

【0061】繰返し単位(2)を与える単量体としては、例えば、下記一般式(5)で表される(メタ)アクリル酸誘導体(以下、「(メタ)アクリル酸誘導体(5)」という。」を挙げることができる。

[0062]

【化44】

$$\begin{array}{c}
R^6 \\
C = CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C = C \\
O \\
R^7
\end{array}$$
(5)

【一般式(5) において、 $R^6$  および $R^7$  は一般式(2) のそれぞれ $R^6$  および $R^7$  と同義である。】【0063】(メタ) アクリル酸誘導体(5) の具体例としては、下記式(5-1) から(5-30) で表される化合物等を挙げることができる。

[0064]

【化45】

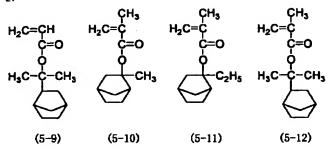
$$H_2C = CH$$
 $C = CH$ 
 $C = CH$ 

[0065]

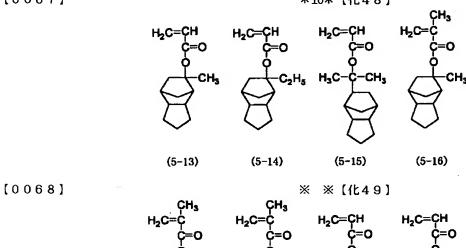
[0066]

【化47】

27



[0067]



(5-17)

[0069]

[0070]

【化51】

$$H_2C=CH$$
 $C=C$ 
 $C=C$ 

[0071] [化52]

【0072】 これらの (x y) アクリル酸誘導体 (5) のうち、式 (5-1)、式 (5-2)、式 (5-3)、式 (5-5)、式 (5-6) または式 (5-7) で表される化合物等が好ましい。樹脂 (A) において、繰返し単位 (2) は、単独でまたは 2 種以上が存在することができる。

【0073】樹脂(A)において、繰返し単位(2)の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、5~70モル%、好ましくは5~60モル%、さらに好ましくは5~50モル%である。この場合、繰返し単位(2)の含有率が5モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する傾向があり、一方70モル%を超えると、得られるレジストの基板への接着性が低下する傾向がある。

【0074】さらに、樹脂(A)は、他の重合性不飽和 単量体に由来する繰返し単位(以下、「他の繰返し単 位」という。)を1種以上有することもできる。好まし い他の繰返し単位としては、例えば、下記一般式(3) で表される繰返し単位(以下、「繰返し単位(3)」と いう。)を挙げることができる。

[0075] [化53]

20 〔一般式(3)において、R°、R°、R°、R°な以R°は相互に独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは非置換の炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、置換もしくは非置換の直鎖状もしくは分岐状の炭素数1~6のアルコキシル基または炭素数2~20の酸解離性基を示し、mは0、1または2の整数である。〕

【0076】一般式(3)において、R°、R¹¹、R¹¹ およびR¹¹のハロゲン原子としては、例えば、ふっ素原子、塩素原子、臭素原子等を挙げることができる。ま た、R°、R¹°、R¹¹ およびR¹¹の置換もしくは非置換の炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロビル基、i-プロビル基、n-ブチル基、2-メチルプロビル基、1-メチルプロビル基、t-ブチル基、n-ヘプチル基、n-ヘキシル基等を挙げることができる。

【0077】また、R°、R¹¹なよびR¹²の置換もしくは非置換の炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、t-ブトキシ基、n-ヘブチルオキシ基、n-ヘキシルオキシ基等を挙げることができる。

【0078】また、R°、R¹°、R¹¹およびR¹²の炭素数2~20の酸解離性基(以下、「酸解離性基(i)」という。)としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、nープロポキシカルボニル基、iープロポキシカルボニル基、nーブトキシカルボニル基、2-メチルプロポキシカルボニル基、tーブトキシカルボニル基、nーペキシルオキシカーベンチルオキシカルボニル基、nーペキシルオキシカ

(17)

ルボニル基、n-ヘプチルオキシカルボニル基、n-オ クチルオキシカルボニル基、n-デシルオキシカルボニ ル基、シクロペンチルオキシカルボニル基、シクロヘキ シルオキシカルボニル基、4-t-ブチルシクロヘキシ ルオキシカルボニル基、シクロヘプチルオキシカルボニ ル基、シクロオクチルオキシカルボニル基等の(シク ロ) アルコキシカルボニル基; フェノキシカルボニル 基、4-t-ブチルフェノキシカルボニル基、1-ナフ チルオキシカルボニル基等のアリーロキシカルボニル 基;ベンジルオキシカルボニル基、4-t-ブチルベン 10 ジルオキシカルボニル基、フェネチルオキシカルボニル 基、4-t-ブチルフェネチルオキシカルボニル基等の アラルキルオキシカルボニル基;1-メトキシエトキシ カルボニル基、1-エトキシエトキシカルボニル基、1 -n-プロポキシエトキシカルボニル基、1-i-プロ ポキシエトキシカルボニル基、1-n-ブトキシエトキ シカルボニル基、1-(2'-メチルプロポキシ)エト キシカルボニル基、1-(1'-メチルプロポキシ)エ トキシカルボニル基、1-t-ブトキシエトキシカルボ ニル基、1-シクロヘキシルオキシエトキシカルボニル 20 基、1-(4'-t-ブチルシクロヘキシルオキシ)エ トキシカルボニル基等の1-(シクロ)アルキルオキシ エトキシカルボニル基; 1-フェノキシエトキシカルボ ニル基、1-(4'-ブチルフェノキシ) エトキシカル ボニル基、1-(1'-ナフチルオキシ) エトキシカル ボニル基等の1-アリーロキシエトキシカルボニル基; 1-ベンジルオキシエトキシカルボニル基、1-(4) - t - ブチルベンジルオキシ) エトキシカルボニル基等

の1-アラルキルオキシエトキシカルボニル基: 【0079】メトキシカルボニルメトキシカルボニル 基、エトキシカルボニルメトキシカルボニル基、 n - プ ロポキシカルボニルメトキシカルボニル基、i-プロポ キシカルボニルメトキシカルボニル基、 n - ブトキシカ ルボニルメトキシカルボニル基、2-メチルプロポキシ カルボニルメトキシカルボニル基、1-メチルプロポキ シカルボニルメトキシカルボニル基、 t - ブトキシカル ボニルメトキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカ ルボニルメトキシカルボニル基、4-t-ブチルシクロ ヘキシルオキシカルボニルメトキシカルボニル基等の (シクロ) アルコキシカルボニルメトキシカルボニル 基;メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニル メチル基、n-プロポキシカルボニルメチル基、i-プ ロポキシカルボニルメチル基、n-ブトキシカルボニル メチル基、2-メチルプロポキシカルボニルメチル基、 1-メチルプロポキシカルボニルメチル基、 t-ブトキ シカルボニルメチル基、シクロヘキシルオキシカルボニ ルメチル基、4-t-ブチルシクロヘキシルオキシカル ボニルメチル基等の(シクロ)アルコキシカルボニルメ チル基:フェノキシカルボニルメチル基、4-t-ブチ

カルボニルメチル基等のアリーロキシカルボニルメチル基;ベンジルオキシカルボニルメチル基、4-t-ブチルベンジルオキシカルボニルメチル基、フェネチルオキシカルボニルメチル基、4-t-ブチルフェネチルオキシカルボニルメチル基等のアラルキルオキシカルボニルメチル基;

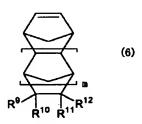
【0080】2-メトキシカルボニルエチル基、2-エ トキシカルボニルエチル基、2-n-プロポキシカルボ ニルエチル基、2 - i - プロポキシカルボニルエチル 基、2-n-ブトキシカルボニルエチル基、2-(2) - メチルプロポキシ) カルボニルエチル基、2 - (1' -メチルプロポキシ) カルボニルエチル基、2-t-ブ トキシカルボニルエチル基、2-シクロヘキシルオキシ カルボニルエチル基、2-(4'-t-ブチルシクロへ キシルオキシカルボニル) エチル基等の2-(シクロ) アルコキシカルボニルエチル基;2-フェノキシカルボ ニルエチル基、2-(4'-t-ブチルフェノキシカル ボニル) エチル基、2-(1'-ナフチルオキシカルボ ニル) エチル基等の2-アリーロキシカルボニルエチル 基:2-ベンジルオキシカルボニルエチル基、2-(4'-t-ブチルベンジルオキシカルボニル) エチル 基、2-フェネチルオキシカルボニルエチル基、2-(4'-t-ブチルフェネチルオキシカルボニル) エチ ル基等の2-アラルキルオキシカルボニルエチル基や、 テトラヒドロフラニルオキシカルボニル基、テトラヒド ロビラニルオキシカルボニル基等を挙げることができ

【0081】 これらの酸解離性基(i)のうち、基-COOR' [但し、R' は炭素数1~19の(シクロ)ア30 ルキル基を示す。】または基-COOCH、COOR' [但し、R'は炭素数1~17の(シクロ)アルキル基を示す。】に相当するものが好ましく、特に好ましくは、t-ブトキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニルメトキシカルボニル基である。また、一般式(3)におけるmとしては、0または1が好ましい。

【0082】繰返し単位(3)を与える単量体としては、例えば、下記一般式(6)で表されるノルボルネン誘導体(以下、「ノルボルネン誘導体(6)」という。)を挙げることができる。

40 [0083]

【化54】



およびmと同義である。〕

【0084】ノルボルネン誘導体(6)のうち、mが0 で、かつ酸解離性基(i)を有する化合物の具体例とし ては、5-メトキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-エトキシカルボニルビシクロ[ 2.2.1]ヘプト-2-エン、5-n-プロポキシカ ルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5 - i - プロポキシカルボニルビシクロ[2.2.1]へ プト-2-エン、5-n-ブトキシカルボニルビシクロ  $[2, 2, 1] \land 7 \land -2 - 2 \lor 5 - (2' - 3) \lor 10$ プロポキシ) カルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト -2-エン、5-(1'-メチルプロポキシ)カルボニ ルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2 -エン、5-シクロヘキシルオキシカルボニルビシクロ [2.2.1]ヘプト-2-エン、5-(4'-t-ブ チルシクロヘキシルオキシ)カルボニルビシクロ[2. 2. 1 ] ヘプトー2ーエン、5ーフェノキシカルボニル ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-(1) -エトキシエトキシ) カルボニルビシクロ[2.2.1 20 シクロ[2.2.1 ]へプト-2-エン、5,6-ジ ]ヘプト-2-エン、5-(1'-シクロヘキシルオキ シエトキシ) カルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト -2-エン、5-t-プトキシカルボニルメトキシカル ボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-テトラヒドロフラニルオキシカルボニルビシクロ[2. 2. 1 ] ヘプトー2ーエン、5ーテトラヒドロピラニル オキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-

33

【0085】5-メチル-5-メトキシカルボニルビシ クロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチル-5 30 -エトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプトー 2-エン、5-メチル-5-n-プロポキシカルボニル ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチル -5-i - プロポキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ]ヘプト-2-エン、5-メチル-5-n-ブトキシカ ルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5 -メチル-5-(2'-メチルプロポキシ)カルボニル ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチル -5-(1'-メチルプロポキシ)カルボニルビシクロ [2.2.1] $^{7}$  $^{1}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{3}$  $^{4}$  $^{5}$  $^{4}$  $^{4}$  $^{5}$  $^{6}$  $^{7}$  $^{1}$  $^{1}$  $^{1}$  $^{1}$  $^{1}$  $^{1}$  $^{2}$  $^{3}$  $^{4}$  $^{5}$  $^{6}$  $^{7}$  $^{1$ -ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプトー 2~エン、5~メチル~5~シクロヘキシルオキシカル ボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチル-5-(4'-t-ブチルシクロヘキシルオキ シ) カルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エ ン、5-メチル-5-フェノキシカルボニルビシクロ[ 2. 2. 1 1ヘプト-2-エン、5-メチル-5-(1'-エトキシエトキシ)カルボニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ー(1'ー シクロヘキシルオキシエトキシ) カルボニルビシクロ[

2. 2. 1 ]ヘプト-2-エン、5-メチル-5-t-ブトキシカルボニルメトキシカルボニルビシクロ[2. 2. 1 ] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーテトラヒ ドロフラニルオキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーテトラヒドロピラ ニルオキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプトー 2-エン、

【0086】5、6-ジ(メトキシカルボニル) ビシク ロ[2,2,1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(エト キシカルボニル) ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(n-プロポキシカルボニル)ピシク ロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(i-プロポキシカルボニル) ビシクロ[2.2.1]ヘプト -2-エン、5,6-ジ(n-ブトキシカルボニル)ビ シクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ (2'-メチルプロポキシカルボニル) ビシクロ[2. 2. 1 ]ヘプト-2-エン、5, 6-ジ(1'-メチル プロポキシカルボニル) ビシクロ[2.2.1]ヘプト -2-エン、5,6-ジ(t-ブトキシカルボニル)ビ (シクロヘキシルオキシカルボニル) ビシクロ[2. 2. 1 ] ヘプトー2ーエン、5, 6ージ(4'ーtーブ チルシクロヘキシルオキシカルボニル) ビシクロ[2. 2. 1 ]ヘプト-2-エン、5, 6-ジ(フェノキシカ ルボニル) ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、 5, 6-ジ(1'-エトキシエトキシカルボニル)ビシ クロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ (1'-シクロヘキシルオキシエトキシカルボニル)ビ シクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ (t-ブトキシカルボニルメトキシカルボニル) ビシク ロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(テト ラヒドロフラニルオキシカルボニル) ビシクロ[2. 2. 1  $] \land \neg \uparrow \land -2 - x \rightarrow (5, 6 - ) (7 + 5 + 5 + 5 + 7)$ ピラニルオキシカルボニル) ビシクロ[2.2.1]へ プト-2-エン等を挙げることができる。 【0087】また、ノルボルネン誘導体(6)のうち、

例としては、8-メトキシカルボニルテトラシクロ[ 4. 4. 0. 12.5 . 17.10 1ドデカー3ーエン、8ー エトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. 12.5. 17.10 ]ドデカー3ーエン、8-n-プロポキ シカルボニルテトラシクロ[4.4.0.12.5.1 7.10 ]ドデカー3-エン、8-i-プロポキシカルボニ ルテトラシクロ[4.4.0.12.3.17.10]ドデカ -3-エン、8-n-ブトキシカルボニルテトラシクロ [4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3ーエン、8 - (2'-メチルプロポキシ)カルボニルテトラシクロ [ 4. 4. 0. 12.5. 17.10 ]ドデカー3ーエン、8 - (1'-メチルプロポキシ)カルボニルテトラシクロ 50 [4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3ーエン、8

mが1で、かつ酸解離性基(i)を有する化合物の具体

(19)

-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. 1'.' . 1''' ]ドデカー3ーエン、8ーシクロヘキシ ルオキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0. 1'.'. 1''.' ]ドデカー3-エン、8-(4'-t-ブチルシクロヘキシルオキシ) カルボニルテトラシクロ [4.4.0.11.1.1]ドデカー3ーエン、8 -フェノキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 <sup>2.5</sup> . 1<sup>7.10</sup> ]ドデカー3ーエン、8 - (1' -エトキ シエトキシ) カルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 <sup>2</sup>.<sup>3</sup>. 1<sup>7,10</sup> ]ドデカー3ーエン、8 - (1' -シクロ ヘキシルオキシエトキシ) カルボニルテトラシクロ[ 4. 4. 0. 12.5 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、8t - ブトキシカルボニルメトキシカルボニルテトラシク ロ[4.4.0.1<sup>2.5</sup>.1<sup>7.10</sup>]ドデカー3ーエン、 8-テトラヒドロフラニルオキシカルボニルテトラシク ロ[4.4.0.12, 17,10]ドデカー3ーエン、 8-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルテトラシク ロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3ーエン、 【0088】8-メチル-8-メトキシカルボニルテト ラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3-20 エン、8-メチル-8-エトキシカルボニルテトラシク ロ[4.4.0.11.5.17.10]ドデカー3ーエン、 8-メチル-8-n-プロポキシカルボニルテトラシク ロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3ーエン、 8-メチル-8-i-プロポキシカルボニルテトラシク ロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3ーエン、 8-メチル-8-n-ブトキシカルボニルテトラシクロ [4.4.0.11, 17,10]ドデカー3ーエン、8 ーメチルー8-(2'-メチルプロポキシ)カルボニル テトラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー 3-エン、8-メチル-8-(1'-メチルプロポキ シ) カルボニルテトラシクロ[4.4.0.12.5.1 7·1° ]ドデカー3-エン、8-メチル-8-t-ブトキ シカルボニルテトラシクロ[4.4.0.12.5.1 <sup>7,10</sup> ]ドデカー3ーエン、8-メチル-8-シクロヘキ シルオキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 2.5 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、8ーメチルー8ー・ (4'-t-ブチルシクロヘキシルオキシ) カルボニル テトラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー 3-エン、8-メチル-8-フェノキシカルボニルテト 40 ラシクロ[ 4. 4. 0. 12.3 . 17.10 ]ドデカー3ー エン、8-メチル-8-(1'-エトキシエトキシ)カ ルボニルテトラシクロ[4.4.0.1'.'.1'] ドデカー3-エン、8-メチル-8-(1'-シクロへ キシルオキシエトキシ) カルボニルテトラシクロ[4. 4. 0. 12,5. 17,10 ]ドデカー3ーエン、8ーメチ ル-8-t-ブトキシカルボニルメトキシカルボニルテ トラシクロ[4.4.0.11.5.17.10]ドデカー3 -エン、8-メチル-8-テトラヒドロフラニルオキシ カルボニルテトラシクロ[4.4.0.12.5.17.10 50

]ドデカー3ーエン、8ーメチルー8ーテトラヒドロビ ラニルオキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 <sup>2.5</sup> . 1<sup>7.10</sup> ]ドデカー3ーエン、 【0089】8、9-ジ(メトキシカルボニル)テトラ シクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3-エ ン、8,9-ジ(エトキシカルボニル)テトラシクロ[ 4. 4. 0. 12.5 . 17.10]ドデカー3ーエン、8, 9-ジ(n-プロポキシカルボニル)テトラシクロ[ 4. 4. 0. 12.5 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、8, 9-ジ(i-プロポキシカルボニル)テトラシクロ[ 4. 4. 0. 12.5. 17.10 ]ドデカー3ーエン、8, 9-ジ(n-ブトキシカルボニル)テトラシクロ[4. 4. 0. 12.5 . 17.10 ]ドデカー3-エン、8, 9-ジ(2'-メチルプロポキシカルボニル)テトラシクロ [4.4.0.1'.' .1'.' ]ドデカー3ーエン、 8, 9-ジ(1'-メチルプロポキシカルボニル)テト ラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3-エン、8,9-ジ(t-ブトキシカルボニル)テトラシ クロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3-エ ン、8,9-ジ(シクロヘキシルオキシカルボニル)テ トラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3 ーエン、8,9-ジ(4'-t-ブチルシクロヘキシル オキシカルボニル) テトラシクロ[4.4.0. 11.5 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、8, 9ージ (フェ ノキシカルボニル)テトラシクロ[4.4.0. 12.5 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、8, 9ージ(1) -エトキシエトキシカルボニル)テトラシクロ[4. 4. 0. 12.3 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、8, 9ー ジ(1'-シクロヘキシルオキシエトキシカルボニル) テトラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー 3-エン、8, 9-ジ(t-ブトキシカルボニルメトキ シカルボニル) テトラシクロ[4.4.0.12.5.1 <sup>7・10</sup> 1ドデカー3ーエン、8、9ージ (テトラヒドロフ ラニルオキシカルボニル)テトラシクロ[4.4.0. 12.5. 17.10.]ドデカー3-エン、8, 9-ジ(テト ラヒドロピラニルオキシカルボニル)テトラシクロ[

【0090】また、ノルボルネン誘導体(6)のうち、酸解離性基(i)をもたない化合物の具体例としては、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシメチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、テトラシクロ[4.4.0.1 $^{2+5}$ .1 $^{7+10}$ ]ドデカ-3-エン、8-メチルテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2+5}$ .1 $^{7+10}$ ]ドデカ-3-エン、8-エチルテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2+5}$ .1 $^{7+10}$ ]ドデカ-3-エン、8-ヒドロキシテトラシクロ[4.4.0.1

4. 4. 0. 12.3. 17.10 ]ドデカー3-エン等が挙

げることができる。

\*\*\* . 1'\*\*\* ]ドデカ-3-エン、8-ヒドロキシメチルテトラシクロ[4.4.0.1\*\*\* . 1'\*\*\* ]ドデカ-3-エン、8-フルオロテトラシクロ[4.4.0.1\*\*\* . 1'\*\*\* ]ドデカ-3-エン、8-フルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1\*\*\* . 1'\*\*\* ]ドデカ-3-エン、8-ジフルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1\*\*\* . 1'\*\*\* ]ドデカ-3-エン、8-トリフルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1\*\*\* . 1'\*\* ]ドデカ-3-エン、8-ペンタフルオロエチルテトラシクロ[4.4.0.1\*\*\* . 1'\*\* ]ドデカ-3 10-エン、

37

【0091】8、8-ジフルオロテトラシクロ[4. 4. 0. 12.5 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、8, 9ー ジフルオロテトラシクロ[4.4.0.12.5.17.10 ]ドデカー3ーエン、8、8ービス(トリフルオロメチ ル) テトラシクロ[4.4.0.1'.' .1'.'0]ドデ カー3-エン、8, 9-ビス (トリフルオロメチル) テ トラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3 -エン、8-メチル-8-トリフルオロメチルテトラシ クロ[4.4.0.1<sup>2.5</sup>.1<sup>7.10</sup>]ドデカー3-エ ン、8,8,9-トリフルオロテトラシクロ[4.4. 0. 1<sup>2,5</sup> . 1<sup>7,10</sup> ]ドデカー3-エン、8, 8, 9-トリス (トリフルオロメチル) テトラシクロ[4.4. 0.12.5.17.10]ドデカー3ーエン、8,8,9, 9ーテトラフルオロテトラシクロ[4.4.0. 1'.' . 1'.' ]ドデカー3-エン、8,8,9,9-テトラキス (トリフルオロメチル) テトラシクロ[4. 4. 0. 12.5 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、 【0092】8、8-ジフルオロ-9、9-ビス(トリ フルオロメチル) テトラシクロ[4.4.0.12.3.  $1^{7.10}$  ]  $\vec{r}$   $\vec$ 9-ビス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4. 4. 0. 12.5 . 17.10 ]ドデカー3-エン、8, 8, 9-トリフルオロ-9-トリフルオロメチルテトラシク ロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3ーエン、 8, 8, 9-トリフルオロ-9-トリフルオロメトキシ テトラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー 3-エン、8,8,9-トリフルオロ-9-ベンタフル オロプロポキシテトラシクロ[4.4.0.12.5.1 <sup>7.10</sup> ]ドデカー3-エン、8-フルオロ-8-ペンタフ 40 ルオロエチルー9, 9-ビス (トリフルオロメチル) テ トラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3 -エン、8,9-ジフルオロ-8-ヘプタフルオロイソ プロピルー9ートリフルオロメチルテトラシクロ[4. 4. 0. 12.5 , 17.10 ]ドデカー3ーエン、8ークロ ロ-8, 9, 9-トリフルオロテトラシクロ[4.4. 0.11.1.1 17.10 ]ドデカー3-エン、8,9-ジク ロロ-8、9-ビス(トリフルオロメチル)テトラシク ロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデカー3ーエン、 8-(2', 2', 2'-トリフルオロカルボキシエチ 50

ル) テトラシクロ[ 4. 4. 0. 1'.' . 1'.' ]ドデカー3-エン、8-メチル-8-(2', 2', 2'-トリフルオロカルボキシエチル) テトラシクロ[ 4. 4. 0. 1'.' . 1'.' ]ドデカー3-エン等を挙げることができる。

【0093】これらのノルボルネン誘導体(6)のうち、特に、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2.7</sup>.1<sup>7.10</sup>]ドデカー3-エン等が好ましい。

【0094】さらに、繰返し単位(3)以外の他の繰返 し単位を与える単量体としては、例えば、ジシクロペン タジエン、トリシクロ[5.2.1.02.6] デカー8 -エン、トリシクロ[5.2.1.0<sup>2.5</sup>] デカ-3-エン、トリシクロ[4.4.0.11.5] ウンデカー3 ーエン、トリシクロ[6.2.1.01.8]ウンデカー 9-エン、トリシクロ[6.2.1.01.8] ウンデカ -4-エン、テトラシクロ[4.4.0.12.5.1 <sup>7,10</sup>. 0<sup>1,6</sup> ] ドデカー3ーエン、8ーメチルテトラシ クロ[4.4.0.12,5.17,10.01,6]ドデカー 3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4.4.0. 14.5 . 17.12 7ドデカー3ーエン、8ーエチリデンテ トラシクロ[4.4.0.12.5.17.10.01.6]ド デカー3ーエン、ペンタシクロ[6.5.1.13.6. 02.7. 09.13 ]ペンタデカー4-エン、ペンタシクロ [7.4.0.12.5.19.12.08.13]ペンタデカー 3-エンのほか、

 $[0095]\alpha - (xy)$  アクリロイルオキシー $\beta - x$ トキシカルボニルー γ – ブチロラクトン、α – (メタ) アクリロイルオキシーβ-エトキシカルボニル-γ-ブ チロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシーβn-プロポキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ) アクリロイルオキシ-β-i-プロポキシカル ボニルーγープチロラクトン、α-(メタ)アクリロイ ルオキシ-β-n-プトキシカルボニル-γ-ブチロラ クトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-(2-メチルプロポキシ) カルボニル- ャープチロラクトン、 ロポキシ)カルボニルーャープチロラクトン、αー(メ タ) アクリロイルオキシ-β-t-ブトキシカルボニル  $-\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ - (メタ) アクリロイルオキ シーβ-シクロヘキシルオキシカルボニル-γ-ブチロ ラクトン、 $\alpha$ -(メタ) アクリロイルオキシ- $\beta$ -(4 - t - ブチルシクロヘキシルオキシ) カルボニル-γ-プチロラクトン、αー(メタ) アクリロイルオキシーβ -フェノキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ) アクリロイルオキシーβ-(1-エトキシエト キシ) カルボニルーγーブチロラクトン、αー(メタ) アクリロイルオキシーβ-(1-シクロヘキシルオキシ エトキシ) カルボニルーγープチロラクトン、αー(メ

タ) アクリロイルオキシ-β-t-ブトキシカルボニル メトキシカルボニルーγ-ブチロラクトン、α-(メ タ) アクリロイルオキシーβーテトラヒドロフラニルオ キシカルボニルーγーブチロラクトン、αー(メタ)ア クリロイルオキシーβ-テトラヒドロピラニルオキシカ ルボニル-γ-ブチロラクトン、

39

 $[0096]\alpha-$ メトキシカルボニル $-\beta-$ (メタ)ア クリロイルオキシー γ - ブチロラクトン、α - エトキシ カルボニルーβ-(メタ)アクリロイルオキシ-γ-ブ チロラクトン、α-n-プロポキシカルボニル-β-(メタ) アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン、α - i -プロポキシカルボニル-β-(メタ)アクリロイ ルオキシーγーブチロラクトン、α-n-ブトキシカル ボニル-β-(メタ) アクリロイルオキシ-γ-ブチロ ラクトン、α-(2-メチルプロポキシ)カルボニルβ- (メタ) アクリロイルオキシ-γ-ブチロラクト ン、α-(1-メチルプロポキシ)カルボニル-β-(メタ) アクリロイルオキシー γーブチロラクトン、α -t-ブトキシカルボニル-β-(メタ)アクリロイル オキシー γ - ブチロラクトン、α - シクロヘキシルオキ 20 シカルボニルーβ-(メタ)アクリロイルオキシ-γ-ブチロラクトン、α-(4-t-ブチルシクロヘキシル オキシ) カルボニル - β - (メタ) アクリロイルオキシ -γ-ブチロラクトン、α-フェノキシカルボニル-β (メタ)アクリロイルオキシーャーブチロラクトン、  $\alpha - (1 - x + + y + x + + y)$   $\beta - (x + y)$ タ) アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン、α -(1-シクロヘキシルオキシエトキシ) カルボニル-β (メタ)アクリロイルオキシーγーブチロラクトン、 α-t-ブトキシカルボニルメトキシカルボニル-β-(メタ) アクリロイルオキシ-γ-ブチロラクトン、α - テトラヒドロフラニルオキシカルボニル - β - (メ タ) アクリロイルオキシーγ-ブチロラクトン、α-テ トラヒドロピラニルオキシカルボニル-8-(メタ)ア クリロイルオキシーケーブチロラクトン等の酸解離性基 を有する(メタ)アクリロイルオキシラクトン化合物; 【0097】α-(メタ) アクリロイルオキシ-γ-ブ チロラクトン、α- (メタ) アクリロイルオキシ-β-フルオローγーブチロラクトン、α- (メタ) アクリロ イルオキシーβーヒドロキシーγーブチロラクトン、α 40 キシーβーメチルーγーブチロラクトン、βー(メタ) - (メタ) アクリロイルオキシ-β-メチル-γ-ブチ ロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-エ チル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ) アクリロイル オキシ $-\beta$ ,  $\beta$  -ジメチル $-\gamma$  - ブチロラクトン、 $\alpha$  -(xg)  $POUDTUT+D-B-x++D-\gamma-TF$ ロラクトン、β-(メタ) アクリロイルオキシ-γ-ブ チロラクトン、α-フルオロ-β-(メタ)アクリロイ ルオキシー γ - ブチロラクトン、α-ヒドロキシーβ-(メタ) アクリロイルオキシー γ – ブチロラクトン、α

ロラクトン、α-エチル-β-(メタ)アクリロイルオ キシーγーブチロラクトン、α, αージメチルーβー (メタ) アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン、α -メトキシ-β-(メタ) アクリロイルオキシ-γ-ブ チロラクトン、 $\alpha$ - (メタ) アクリロイルオキシ- $\delta$ -メバロノラクトン等の酸解離性基をもたない (メタ) ア クリロイルオキシラクトン化合物;

【0098】(メタ) アクリル酸メチル、(メタ) アク リル酸エチル、 (メタ) アクリル酸n -プロビル、 (メ タ) アクリル酸 i - プロピル、(メタ) アクリル酸n -ブチル、(メタ) アクリル酸 t - ブチル等の他の(メ タ) アクリル酸エステル類; α-ヒドロキシメチルアク リル酸メチル、α-ヒドロキシメチルアクリル酸エチル 等のα-ヒドロキシメチルアクリル酸エステル類:酢酸 ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等のビニルエ ステル類; (メタ) アクリロニトリル、α-クロロアク リロニトリル等の不飽和ニトリル化合物; (メタ)アク リルアミド、N, N-ジメチル (メタ) アクリルアミド 等の不飽和アミド化合物;  $N-ビニル-\varepsilon-カプロラク$ タム、N-ビニルピロリドン、2-ビニルピリジン、3 - ピニルピリジン、4 - ピニルピリジン、N - ビニルイ ミダゾール等の他の含窒素ビニル化合物; (メタ)アク リル酸、クロトン酸、マレイン酸、無水マレイン酸等の 不飽和カルボン酸(無水物)類;(メタ)アクリル酸2 - カルボキシエチル、(メタ) アクリル酸2 - カルボキ シプロビル、(メタ) アクリル酸3-カルボキシプロビ ル等の不飽和カルボン酸のカルボキシル基含有エステル 類等の単官能性単量体や、メチレングリコールジ(メ タ) アクリレート、エチレングリコールジ (メタ) アク 30 リレート、プロピレングリコールジ (メタ) アクリレー ト、1、6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレー ト、2、5-ジメチル-2、5-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレート等の多官能性単量体等を挙げると とができる。

【0099】 これらの繰返し単位(3)以外の他の繰返 し単位を与える単量体のうち、無水マレイン酸、(メ タ)アクリロイルオキシラクトン化合物等が好ましく、 特に、無水マレイン酸、α-(メタ) アクリロイルオキ シー γ - ブチロラクトン、α - (メタ) アクリロイルオ アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン、α - (メ タ) アクリロイルオキシー δ-メバロノラクトン等が好 ましい。なお、無水マレイン酸は、ノルボルネン誘導体 (6) との共重合性が良好であり、樹脂(A) がノルボ ルネン誘導体(6)に由来する繰返し単位(3)を有す る場合、無水マレイン酸をノルボルネン誘導体(6)と 共重合させることにより、得られる樹脂(A)の分子量 を所望の値にまで大きくすることができる。前記繰返し 単位(3)以外の他の繰返し単位を与える単量体は、単 ーメチルーβー(メタ)アクリロイルオキシーγーブチ 50 独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

【0100】樹脂(A)において、繰返し単位(3)の 含有率は、全繰返し単位に対して、通常、60モル%以 下、好ましくは5~50モル%、さらに好ましくは10 ~40モル%であり、また繰返し単位(3)以外の他の 繰返し単位の含有率は、通常、60モル%以下、好まし くは50モル%以下、さらに好ましくは40モル%以下 である。この場合、繰返し単位(3)およびそれ以外の 他の繰返し単位の各含有率が60モル%を超えると、レ ジストとしての解像度が低下する傾向がある。

41

【0101】樹脂(A)は、例えば、(メタ)アクリル 10 酸誘導体(4)および(メタ)アクリル酸誘導体(5) を、場合により他の繰返し単位を与える単量体ととも に、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパーオキシド 類、ジアシルパーオキシド類、アゾ化合物等のラジカル 重合開始剤を使用し、適当な溶媒中で共重合することに より製造することができる。共重合に使用される溶媒と しては、例えば、n-ペンタン、n-ヘキサン、n-ヘ プタン、n-オクタン、n-ノナン、n-デカン等のア ルカン類;シクロヘキサン、シクロヘブタン、シクロオ クタン、デカリン、ノルボルナン等のシクロアルカン 類:ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 クメン等の芳香族炭化水素類:クロロブタン類、ブロモ ヘキサン類、ジクロロエタン類、ヘキサメチレンジブロ ミド、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;酢酸 エチル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、プロピオン 酸メチル等の飽和カルボン酸エステル類;テトラヒドロ フラン、ジメトキシエタン類、ジエトキシエタン類等の エーエル類等を挙げることができる。これらの溶媒は、 単独でまたは2種以上を混合して使用することができ る。

【0102】樹脂(A)のゲルパーミエーションクロマ トグラフィー(GPC)によるポリスチレン換算重量平 均分子量(以下、「Mw」という。)は、通常、3.0 00~300,000、好ましくは4,000~20 0,000、さらに好ましくは5,000~100,0 00である。この場合、樹脂(A)のMwが3,000 未満では、レジストとしての耐熱性が低下する傾向があ り、一方300、000を超えると、レジストとしての 現像性が低下する傾向がある。なお、本発明における樹 脂(A)は、ハロゲン、金属等の不純物が少ないほど好 40 ましく、それにより、感放射線性樹脂組成物のレジスト としての感度、解像度、プロセス安定性、バターン形状 等がさらに改善される。樹脂(A)の精製法としては、 例えば、水洗、液々抽出等の化学的精製法や、これらの 化学的精製法と限外ろ過、遠心分離等の物理的精製法と の組み合わせ等を挙げることができる。本発明におい て、樹脂(A)は、単独でまたは2種以上を混合して使 用することができる。

【0103】酸発生剤(B)

本発明における(B)成分は、露光により酸を発生する 50 ト、1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメ

感放射線性酸発生剤(以下、「酸発生剤(B)」とい う。) からなる。酸発生剤(B)は、露光により発生し た酸の作用によって、樹脂(A)中に存在する酸解離性 基を解離させ、その結果レジスト被膜の露光部がアルカ リ現像液に易溶性となり、ポジ型のレジストパターンを 形成する作用を有するものである。このような酸発生剤 (B) としては、オニウム塩、ハロゲン含有化合物、ジ アゾケトン化合物、スルホン化合物、スルホン酸化合物 等を挙げることができる。これらの酸発生剤(B)の例 としては、下記のものを挙げることができる。

【0104】オニウム塩:オニウム塩としては、例え ば、ヨードニウム塩、スルホニウム塩(テトラヒドロチ オフェニウム塩を含む。)、ホスホニウム塩、ジアゾニ ウム塩、ピリジニウム塩等を挙げることができる。好ま しいオニウム塩の具体例としては、ジフェニルヨードニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨー ドニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート、ジフ ェニルヨードニウムピレンスルホネート、ジフェニルヨ ードニウム n-ドデシルベンゼンスルホネート、ジフ 20 ェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジ フェニルヨードニウムナフタレンスルホネート、ジフェ ニルヨードニウム 10-カンファースルホネート、ビ ス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニ ル) ヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネー ト、ビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウムピレ ンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨー ドニウム n-ドデシルベンゼンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムヘキサフルオ 30 ロアンチモネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨ ードニウムナフタレンスルホネート、ピス(4-t-ブ チルフェニル) ヨードニウム 10-カンファースルホ ネート、

【0105】トリフェニルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフル オローn-ブタンスルホネート、トリフェニルスルホニ ウムピレンスルホネート、トリフェニルスルホニウム n-ドデシルベンゼンスルホネート、トリフェニルスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニル スルホニウムナフタレンスルホネート、トリフェニルス ルホニウム 10-カンファースルホネート、4-ヒド ロキシフェニル・フェニル・メチルスルホニウムp-ト ルエンスルホネート、4-ヒドロキシフェニル・ベンジ ル・メチルスルホニウムトルエンスルホネート、シクロ ヘキシル・メチル・2-オキソシクロヘキシルスルホニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘキシ ル・2-オキソシクロヘキシル・スルホニウムトリフル オロメタンスルホネート、ジメチル・2-オキソシクロ ヘキシルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー

タンスルホネート、1-ナフチルジエチルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-シアノ-1-ナ フチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホ ネート、4-ニトロー1-ナフチルジメチルスルホニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、4-メチル-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスル ホネート、4-ヒドロキシー1-ナフチルジメチルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-シアノ -1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、4-ニトロー1-ナフチルジエチルス 10 ができる。好ましいハロゲン含有化合物の具体例として ルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-メチ ルー1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルジエ 【0106】4-ヒドロキシ-1-ナフチルテトラヒド

チルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、 ロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4 -メトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-エトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、4-n-プロポキシ-1-ナフチルテ 20 トラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、4-i-プロポキシ-1-ナフチルテトラヒドロ チオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4n-プトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、4-t-ブトキシ -1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、4-メトキシメトキシ-1-ナ フチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタン スルホネート、4-エトキシメトキシ-1-ナフチルテ ート、4-(1'-メトキシエトキシ)-1-ナフチル テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホ ネート、4-(2'-メトキシエトキシ)-1-ナフチ ルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスル ホネート、4-メトキシカルボニルオキシ-1-ナフチ ルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスル ホネート、4-エトキシカルボニルオキシ-1-ナフチ ルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスル ホネート、4-n-プロポキシカルボニルオキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタ 40 ンスルホネート、4 - i - プロポキシカルボニルオキシ -1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、4-n-ブトキシカルボニルオ キシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、4-t-ブトキシカルボニ ルオキシー1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムト リフルオロメタンスルホネート、4-(2'-テトラヒ ドロフラニルオキシ) -1-ナフチルテトラヒドロチオ フェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-

テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホ ネート、4-ベンジルオキシー1-ナフチルテトラヒド ロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1 - (1'-ナフチルアセトメチル)テトラヒドロチオフ ェニウムトリフルオロメタンスルホネート等を挙げると とができる。

【0.107】ハロゲン含有化合物:ハロゲン含有化合物 としては、例えば、ハロアルキル基含有炭化水素化合 物、ハロアルキル基含有複素環式化合物等を挙げること は、フェニルビス(トリクロロメチル)- s - トリアジ ン、4-メトキシフェニルビス(トリクロロメチル)s-トリアジン、1-ナフチルビス(トリクロロメチ ル) - s - トリアジン等の(トリクロロメチル) - s -トリアジン誘導体や、1,1-ビス(4'-クロロフェ ニル)-2,2,2-トリクロロエタン等を挙げること ができる。

ジアゾケトン化合物:ジアゾケトン化合物としては、例 えば、1、3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジアゾベン ゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等を挙げる ことができる。好ましいジアゾケトンの具体例として は、1、2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニルク ロリド、1、2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニ ルクロリド、2,3,4,4'-テトラヒドロキシベン ゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジド-4-スル ホン酸エステルまたは1,2-ナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸エステル、1, 1, 1-トリス(4'-ヒドロキシフェニル) エタンの1,2-ナフトキノンジ アジド-4-スルホン酸エステルまたは1,2-ナフト トラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネ 30 キノンジアジド-5-スルホン酸エステル等を挙げると とができる。

> スルホン化合物:スルホン化合物としては、例えば、β -ケトスルホン、β-スルホニルスルホンや、これらの 化合物のα-ジアゾ化合物等を挙げることができる。好 ましいスルホン化合物の具体例としては、4-トリルフ ェナシルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、ビス (フェニルスルホニル) メタン等を挙げることができ る。

スルホン酸化合物: スルホン酸化合物としては、例え ば、アルキルスルホン酸エステル、アルキルスルホン酸 イミド、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールス ルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げること ができる。好ましいスルホン酸化合物の具体例として は、ベンゾイントシレート、ピロガロールのトリス(ト リフルオロメタンスルホネート)、ニトロベンジルー 9, 10-ジェトキシアントラセン-2-スルホネー ト、トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2. 1 ]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、N -ヒドロキシスクシイミドトリフルオロメタンスルホネ (2'ーテトラヒドロピラニルオキシ)ー1ーナフチル 50 ート、1,8ーナフタレンジカルボン酸イミドトリフル

オロメタンスルホネート等を挙げることができる。 【0108】これらの酸発生剤(B)のうち、特に、ジ フェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、ピス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリ フルオロメタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフ ェニル) ヨードニウムノナフルオローn-ブタンスルホ ネート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタン スルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロ -n-プタンスルホネート、シクロヘキシル・メチル・ 2-オキソシクロヘキシルスルホニウムトリフルオロメ 10 タンスルホネート、ジシクロヘキシル・2-オキソシク ロヘキシルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、ジメチル・2-オキソシクロヘキシルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシ-1 -ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、4-ヒドロキシー1-ナフチルテトラヒド ロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4 -n-プトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(1'-ナ フチルアセトメチル)テトラヒドロチオフェニウムトリ フルオロメタンスルホネート、トリフルオロメタンスル ホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、N-ヒドロキシスクシイミドト リフルオロメタンスルホネート、1,8-ナフタレンジ カルボン酸イミドトリフルオロメタンスルホネート等が 好ましい。

【0109】本発明において、酸発生剤(B)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。酸発生剤(B)の使用量は、レジストとしての感度および現像性を確保する観点から、樹脂(A)100重量部に 30対して、通常、0.1~10重量部、好ましくは0.5~7重量部である。この場合、酸発生剤(B)の使用量が0.1重量部未満では、レジストとしての感度および現像性が低下する傾向があり、一方10重量部を超えると、放射線に対する透明性が低下して、レジストとして矩形のレジストパターンを得られ難くなる傾向がある。

#### 【0110】各種添加剤

本発明の感放射線性樹脂組成物は、露光により酸発生剤(B)から生じる酸のレジスト被膜中における拡散現象を制御し、非露光領域での好ましくない化学反応を抑制する作用を有する酸拡散制御剤を配合することができる。このような酸拡散制御剤を使用することにより、組成物の貯蔵安定性がより向上し、またレジストとして解像度がさらに向上するとともに、露光から現像までの引き置き時間(PED)の変動によるレジストバターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性がさらに改善される。酸拡散制御剤としては、レジストバターンの形成工程中の露光や加熱処理により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。このような含窒素有機化合物としては、例えば、下記一般式(7)

[0111] [化55]

【0112】(一般式(7) において、R<sup>11</sup>、R<sup>11</sup>およ びR11は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の アルキル基、置換もしくは非置換のアリール基または置 換もしくは非置換のアラルキル基を示す。〕で表される 化合物(以下、「含窒素化合物(イ)」という。)、同 一分子内に窒素原子を2個有するジアミノ化合物(以 下、「含窒素化合物(ロ)」という。)、窒素原子を3 個以上有するジアミノ重合体(以下、「含窒素化合物 (ハ)」という。)、アミド基含有化合物、ウレア化合 物、含窒素複素環化合物等を挙げることができる。含窒 素化合物(イ)としては、例えば、n-ヘキシルアミ ン、n-ヘプチルアミン、n-オクチルアミン、n-ノ ニルアミン、n-デシルアミン、シクロヘキシルアミン 等のモノ(シクロ)アルキルアミン類;ジ-n-ブチル アミン、ジーn-ペンチルアミン、ジーn-ヘキシルア ミン、ジーn-ヘプチルアミン、ジーn-オクチルアミ ン、ジーnーノニルアミン、ジーnーデシルアミン、シ クロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等 のジ(シクロ)アルキルアミン類;トリエチルアミン、 トリーnープロピルアミン、トリーnーブチルアミン、 トリーnーペンチルアミン、トリーnーヘキシルアミ ン、トリーnーヘプチルアミン、トリーnーオクチルア ミン、トリーnーノニルアミン、トリーnーデシルアミ ン、シクロヘキシルジメチルアミン、メチルジシクロヘ キシルアミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリ(シ クロ) アルキルアミン類: アニリン、N-メチルアニリ ン、N、N - ジメチルアニリン、2 - メチルアニリン、 3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、4-ニトロ アニリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、1 -ナフチルアミン等の芳香族アミン類等を挙げることが できる。

【0113】含窒素化合物(ロ)としては、例えば、エチレンジアミン、N, N, N', N', ーテトラメチルエチレンジアミン、ヘキサメチ40 レンジアミン、4, 4', ージアミノジフェニルメタン、4, 4', ージアミノジフェニルエーテル、4, 4', ージアミノジフェニルエーテル、4, 4', ージアミノジフェニルン、2, 2ービス(4', ーアミノフェニル)プロパン、2ー(4', ーアミノフェニル)プロパン、2ー(4', ーアミノフェニル)プロパン、2ー(4', ーアミノフェニル)プロパン、2ー(4', ーアミノフェニル)プロパン、1, 4ービス[1', ー(4', ーアミノフェニル)プロパン、1, 4ービス[1', ー(4', ーアミノフェニル)ー1', メチルエチル]ベンゼン、1, 3 ービス[1', ー(4', ーアミノフェニル)ー1', ーメチ

ルエチル〕ベンゼン等を挙げることができる。含窒素化 合物(ハ)としては、例えば、ポリエチレンイミン、ポ リアリルアミン、ジメチルアミノエチルアクリルアミド の重合体等を挙げることができる。前記アミド基含有化 合物としては、例えば、ホルムアミド、N-メチルホル ムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミ ド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセト アミド、プロピオンアミド、ベンズアミド、ピロリド ン、N-メチルピロリドン等を挙げることができる。前 記ウレア化合物としては、例えば、尿素、メチルウレ ア、1、1-ジメチルウレア、1、3-ジメチルウレ ア、1、1、3、3-テトラメチルウレア、1、3-ジ フェニルウレア、トリーnーブチルチオウレア等を挙げ ることができる。前記含窒素複素環化合物としては、例 えば、イミダゾール、ベンズイミダゾール、4-メチル イミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール 等のイミダゾール類;ピリジン、2-メチルピリジン、 4-メチルピリジン、2-エチルピリジン、4-エチル ピリジン、2-フェニルピリジン、4-フェニルピリジ ン、2-メチル-4-フェニルピリジン、ニコチン、ニ 20 コチン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、4-ヒドロキ シキノリン、8-オキシキノリン、アクリジン等のピリ ジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キ ノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、モルホリ ン、4-メチルモルホリン、ピペラジン、1,4-ジメ チルピペラジン、1-(2'-ヒドロキシエチル)ピペ ラジン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタ ン等を挙げることができる。

【0114】これらの含窒素有機化合物のうち、含窒素化合物(イ)、含窒素複素環化合物等が好ましい。また、含窒素化合物(イ)の中では、トリ(シクロ)アルキルアミン類が特に好ましく、含窒素複素環化合物の中では、ビリジン類、ビベラジン類が特に好ましい。前記酸拡散制御剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。酸拡散制御剤の配合量は、樹脂

(A) 100重量部に対して、通常、15重量部以下、好ましくは10重量部以下、さらに好ましくは5重量部以下である。この場合、酸拡散制御剤の配合量が15重量部を超えると、レジストとしての感度や露光部の現像性が低下する傾向がある。なお、酸拡散制御剤の配合量 40が0.001重量部未満では、プロセス条件によっては、レジストとしてのバターン形状や寸法忠実度が低下するおそれがある。

【0115】また、本発明の感放射線性樹脂組成物には、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との接着性等をさらに改善する作用を示す、酸解離性有機基を有する脂環族添加剤を配合することができる。このような脂環族添加剤としては、例えば、1-アダマンタンカルボン酸 t-ブチル、3-アダマンタンシカルボン酸ジー t-ブ

チル、1-アダマンタン酢酸 t-ブチル、3-アダマン タン酢酸 t-ブチル、1,3-アダマンタンジ酢酸ジー t-ブチル等のアダマンタン誘導体類;デオキシコール 酸 t - ブチル、デオキシコール酸 t - ブトキシカルボニ ルメチル、デオキシコール酸2-エトキシエチル、デオ キシコール酸2 -シクロヘキシルオキシエチル、デオキ シコール酸3-オキソシクロヘキシル、デオキシコール 酸テトラヒドロピラニル、デオキシコール酸メバロノラ クトンエステル等のデオキシコール酸エステル類;リト 10 コール酸 t - ブチル、リトコール酸 t - ブトキシカルボ ニルメチル、リトコール酸2-エトキシエチル、リトコ ール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸 3-オキソシクロヘキシル、リトコール酸テトラヒドロ ピラニル、リトコール酸メバロノラクトンエステル等の リトコール酸エステル類等を挙げることができる。これ らの脂環族添加剤は、単独でまたは2種以上を混合して 使用することができる。脂環族添加剤の配合量は、樹脂 (A) 100重量部に対して、通常、50重量部以下、 好ましくは30重量部以下である。この場合、脂環族添 加剤の配合量が50重量部を超えると、レジストとして の耐熱性が低下する傾向がある。

【0116】また、他の添加剤としては、塗布性、現像 性等を改良する作用を示す界面活性剤を挙げることがで きる。前記界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエ チレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリ ルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポ リオキシエチレンn-オクチルフェニルエーテル、ポリ オキシエチレンn - ノニルフェニルエーテル、ポリエチ レングリコールジラウレート、ポリエチレングリコール 30 ジステアレート等のノニオン系界面活性剤のほか、以下 商品名で、KP341 (信越化学工業(株)製)、ポリ フローNo. 75, 同No. 95 (共栄社化学 (株) 製)、エフトップEF301、同EF303、同EF3 52 (トーケムプロダクツ (株) 製)、メガファックス F171、同F173 (大日本インキ化学工業(株) 製)、フロラードFC430, 同FC431 (住友スリ ーエム(株)製)、アサヒガードAG710, サーフロ ンS-382, 同SC-101, 同SC-102, 同S C-103, 同SC-104, 同SC-105, 同SC -106(旭硝子(株)製)等を挙げることができる。 これらの界面活性剤は、単独でまたは2種以上を混合し て使用することができる。界面活性剤の配合量は、樹脂 (A)と酸発生剤(B)との合計100重量部に対し て、通常、2重量部以下である。また、前記以外の添加 剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定 化剤、消泡剤等を挙げることができる。

# 【0117】組成物溶液の調製

な脂環族添加剤としては、例えば、1-アダマンタンカ 本発明の感放射線性樹脂組成物は、通常、その使用に際ルボン酸 t-ブチル、3-アダマンタンカルボン酸 t- して、全固形分濃度が、例えば 5-0 重量%、好まし ブチル、1, 3-アダマンタンジカルボン酸ジー 1-7 50 くは 10-2 5 重量%となるように、溶剤に溶解したの

ち、例えば孔径0. 2μm程度のフィルターでろ過する ことによって、組成物溶液として調製される。前記組成 物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、2-ブタノン、2-ペンタノン、3-メチル-2-ブタノ ン、2-ヘキサノン、4-メチル-2-ペンタノン、3 -メチル-2-ペンタノン、3,3-ジメチル-2-ブ タノン、2-ヘプタノン、2-オクタノン等の直鎖状も しくは分岐状のケトン類:シクロペンタノン、2-メチ ルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-メチルシ クロヘキサノン、2、6-ジメチルシクロヘキサノン、 イソホロン等の環状のケトン類;プロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノーn-プロピルエーテルアセテート、プロピレング リコールモノーi-プロピルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールモノ-n-ブチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールモノ - i - ブチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノー s e c - ブチル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノー t-ブチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモ 20 ノアルキルエーテルアセテート類;2-ヒドロキシプロ ピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシプロピオン酸n-プロピル、2-ヒドロ キシプロピオン酸 i - プロピル、2 - ヒドロキシプロピ オン酸n-ブチル、2-ヒドロキシプロピオン酸 i-ブ チル、2-ヒドロキシプロピオン酸sec-ブチル、2 -ヒドロキシプロピオン酸 t - ブチル等の2 -ヒドロキ シプロピオン酸アルキル類のほか、

【0118】nープロピルアルコール、iープロピルア ルコール、n-ブチルアルコール、t-ブチルアルコー ル、シクロヘキサノール、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノーnープロピルエーテル、エチ レングリコールモノー n - ブチルエーテル、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジ エチルエーテル、ジエチレングリコールジーn-プロピ ルエーテル、ジェチレングリコールジ-n-ブチルエー テル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノ-n-プロピルエーテルア 40 セテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレン グリコールモノー n - プロピルエーテル、トルエン、キ シレン、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3ーメチル酪酸メチル、3ーメトキシブチ ルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテ ート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネー ト、3-メチル-3-メトキシブチルブチレート、酢酸 エチル、酢酸n-プロピル、酢酸n-ブチル、アセト酢 50

酸メチル、アセト酢酸エチル、3-メトキシプロピオン 酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン 酸メチル、ビルビン酸エチル、N-メチルピロリドン、 N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセ トアミド、ベンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテ ル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチ レングリコールモノエチルエーテル、カプロン酸、カプ リル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジル アルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸 10 ジエチル、マレイン酸ジエチル、ケープチロラクトン、 炭酸エチレン、炭酸プロピレン等を挙げることができ る。これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して 使用することができるが、就中、直鎖状もしくは分岐状 のケトン類、環状のケトン類、プロピレングリコールモ ノアルキルエーテルアセテート類、2-ヒドロキシプロ ピオン酸アルキル類が好ましい。

# 【0119】レジストパターンの形成方法

本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジ ストとして有用である。前記化学増幅型レジストにおい ては、露光により酸発生剤(B)から発生した酸の作用 によって、樹脂(A)中の酸解離性基が解離して、例え ばカルボキシル基等の酸性官能基に変換される反応を生 じ、その結果レジストの露光部のアルカリ現像液に対す る溶解性が高くなり、該露光部がアルカリ現像液によっ て溶解、除去され、ポジ型のレジストパターンが得られ る。本発明の感放射線性樹脂組成物からレジストバター ンを形成する際には、感放射線性樹脂組成物を、回転塗 布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布手段によっ て、例えば、シリコンウエハー、アルミニウムで被覆さ れたウエハー等の基板上に塗布することにより、レジス ト被膜を形成し、場合により予めプレベーク(以下、 「PB」という。)を行ったのち、所定のレジストパタ ーンを形成するように該レジスト被膜に露光する。その 際に使用される放射線としては、酸発生剤(B)の種類 に応じて、遠紫外線、X線、電子線等を適宜選定して使 用することができるが、特に、ArFエキシマレーザー (波長193nm) あるいはKrFエキシマレーザー (波長248nm)が好ましい。本発明においては、露 光後に加熱処理(以下、「PEB」という。)を行うこ とが好ましい。このPEBにより、樹脂(A)中の酸解 離性基の解離反応が円滑に進行する。PEBの加熱条件 は、感放射線性樹脂組成物の配合組成によって変わる が、通常、30~200℃、好ましくは50~170℃ である。本発明においては、感放射線性樹脂組成物の潜 在能力を最大限に引き出すため、例えば特公平6-12 452号公報等に開示されているように、使用される基 板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成してお くこともでき、また環境雰囲気中に含まれる塩基性不純 物等の影響を防止するため、例えば特開平5-1885 98号公報等に開示されているように、レジスト被膜上 に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技術を 併用することもできる。

【0120】次いで、露光されたレジスト被膜を現像す ることにより、所定のレジストパターンを形成する。現 像に使用される現像液としては、例えば、水酸化ナトリ ウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、けい酸ナトリ ウム、メタけい酸ナトリウム、アンモニア水、エチルア ミン、n-プロピルアミン、ジエチルアミン、ジ-n-プロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルア ミン、エチルジメチルアミン、トリエタノールアミン、 テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、ピロール、ピ ペリジン、コリン、1、8-ジアザビシクロー[5. 4.0]-7-ウンデセン、1,5-ジアザビシクロー [4.3.0]-5-ノネン等のアルカリ性化合物の少 なくとも1種を溶解したアルカリ性水溶液が好ましい。 前記アルカリ性水溶液の濃度は、通常、10重量%以下 である。この場合、アルカリ性水溶液の濃度が10重量 %を超えると、未露光部も現像液に溶解し、好ましくな い。また、前記アルカリ性水溶液からなる現像液には、 例えば有機溶剤を添加することもできる。前記有機溶剤 20 の具体例としては、アセトン、2-ブタノン、4-メチ ルー2ーペンタノン、シクロペンタノン、2ーメチルシ クロペンタノン、シクロヘキサノン、2,6-ジメチル シクロヘキサノン等のケトン類;メチルアルコール、エ チルアルコール、n-プロピルアルコール、i-プロピ ルアルコール、n-ブチルアルコール、t-ブチルアル コール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、 1, 4-ヘキサンジオール、1, 4-ヘキサンジメチロ ール等のアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサ ン等のエーテル類: 酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸 30 i-アミル等のエステル類;トルエン、キシレン等の芳 香族炭化水素類や、フェノール、アセトニルアセトン、 ジメチルホルムアミド等を挙げることができる。これら の有機溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用す ることができる。有機溶剤の使用量は、アルカリ性水溶 液に対して、100容量%以下が好ましい。この場合、 有機溶剤の使用量が100容量%を超えると、現像性が 低下し、露光部の現像残りが多くなるおそれがある。ま た、アルカリ性水溶液からなる現像液には、界面活性剤 等を適量添加することもできる。なお、アルカリ性水溶 40 液からなる現像液で現像したのちは、一般に、水で洗浄 して乾燥する。

## [0121]

【発明の実施の形態】以下、実施例を挙げて、本発明の 実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明 は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。こ こで、部および%は、特記しない限り重量基準である。 実施例および比較例における各測定・評価は、下記の要 領で行った。

本、G3000HXL 1本、G4000HXL 1本)を用 い、流量1.0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒド ロフラン、カラム温度40°Cの分析条件で、単分散ポリ スチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグ

52

ラフィー (GPC) により測定した。

保存安定性:組成物溶液をシリコンウエハー上にスピン コートにより塗布し、140℃に保持したホットプレー ト上で90秒間 PBを行って作製した膜厚1μmのレジ スト被膜を、2.38%テトラメチルアンモニウムヒド ロキシド水溶液により、25℃で1分間現像し、水洗 し、乾燥したのち、膜厚を測定した。これを、初期残膜 厚とする。また、組成物溶液を50℃の恒温槽に保持 し、保持後の組成物溶液から毎日、前記と同様にしてレ ジスト被膜の作製、現像、水洗および乾燥を行ったの ち、保持後の残膜厚を測定した。このとき、初期残膜厚 に対する保持後の残膜厚の変化率が50%を超えるのに 要する日数を求めて、保存安定性の尺度とした。この日 数が大きいほど、保存安定性が良好であることを示す。 放射線透過率:組成物溶液を石英ガラス上にスピンコー トにより塗布し、90℃に保持したホットプレート上で 60秒間PBを行って作製した膜厚1 μmのレジスト被 膜について、波長193nmにおける吸光度から、透過 率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とし た。

【0122】相対エッチング速度:組成物溶液をシリコ ンウエハ上にスピンコートした乾燥膜厚0.5μmのレ ジスト被膜に対して、PMT社製ドライエッチング装置 (Pinnacle8000) を用い、エッチングガスをCF。と し、ガス流量75sccm、圧力2.5mToor、出 力2500 Wの条件でドライエッチングを行って、エッ チング速度を測定し、クレゾールノボラック樹脂からな る被膜のエッチング速度に対する相対値により、相対エ ッチング速度を評価した。相対エッチング速度の小さい ほど、ドライエッチング耐性に優れることを意味する。 感度:基板として、表面に膜厚520AのDeepUV30 (ブルーワー・サイエンス (Brewer Science) 社製) 膜 を形成したシリコーンウエハー (ARC)を用い、組成 物溶液を基板上にスピンコートしたのち、ホットプレー ト上で、表2に示す条件にてPBを行って、膜厚0.4 μmのレジスト被膜を作製した。このレジスト被膜に、 (株) ニコン製ArFエキシマレーザー露光装置(レン ズ開口数0.55、露光波長193nm) により、マス クパターンを介して露光した。次いで、ホットプレート 上で、表2に示す条件にてPEBを行ったのち、2.3 8%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液(実 施例1~16) または2.38×1/50%テトラメチ ルアンモニウムヒドロキシド水溶液(比較例1)によ り、25℃で1分間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型 レジストパターンを形成した。その際、線幅0.18μ Mw: 東ソー (株) 製GPCカラム (G2000HXL2 50 mのライン・アンド・スペースパターン (1L1S)を

1対1の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この 最適露光量を感度とした。

53

解像度:最適露光量で露光したときに解像される最小の レジストパターンの寸法を解像度とした。

パターン形状:線幅0.20μmのライン・アンド・ス ペースパターン(1 L 1 S) の方形状断面の下辺寸法し 、と上辺寸法し、とを走査型電子顕微鏡により測定し、 85≦L, /L, ≦1を満足し、かつパターン形状 が裾を引いていない場合を、パターン形状が"良好"で あるとし、これらの条件の少なくとも一つを満たさない 10 場合を、パターン形状が"不良"であるとした。

#### 【0123】合成例1

**還流管を装着したセパラブルフラスコに、窒素気流下** で、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート 27部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート\* \*13部、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2. 2. 1 1ヘプト-2-エン40部、無水マレイン酸20 部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒ ドロフラン100部を仕込み、65℃で5時間重合し た。重合終了後、反応溶液を大量のn-ヘキサン/i-プロピルアルコール (重量比=3 /1) 混合溶媒中に注い で、樹脂を凝固させ、凝固した樹脂を同じ混合溶媒で数 回洗浄したのち、真空乾燥して、下記式に示す各繰返し 単位の含有率が (A1-I) 20モル%、 (A1-II) 10モル %、(A1-III) 3 5 モル%、 (A1-IV) 3 5 モル%であり、 Mwが12,000の共重合体を収率60%で得た。と の共重合体を、共重合体(A-1)とする。

[0124]【化56】

#### 【0125】合成例2

仕込み原料として、3-ヒドロキシ-1-アダマンチル メタクリレート4〇部、2-メチル-2-アダマンチル トラシクロ[4.4.0.13.5.17.10]ドデカー3 -エン35部、無水マレイン酸15部、アゾビスイソブ チロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部※

※を用いた以外は、合成例1と同様にして、下記式に示す 各繰返し単位の含有率が (A2-I) 40モル%、 (A2-II) 10モル%、(A2-III)25モル%、(A2-IV)25モル% メタクリレート10部、8-t-ブトキシカルボニルテ 30 であり、Mwが8,000の共重合体を収率62%で得 た。この共重合体を、共重合体(A-2)とする。

> [0126] 【化57】

$$CH_3$$
  $CH_3$   $CH_2$   $CH_2$   $CH_2$   $CH_2$   $CH_3$   $COOC(CH_3)_3$   $COOC(CH_3)_3$   $COOC(CH_3)_3$ 

#### 【0127】合成例3

仕込み原料として、2-(5'-ヒドロキシビシクロ[ 2. 2. 1 1ヘプチル) アクリレート25部、2-メチ ル-2-アダマンチルメタクリレート15部、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2 -エン40部、無水マレイン酸20部、アゾビスイソブ チロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部 50

を用いた以外は、合成例1と同様にして、下記式に示す 各繰返し単位の含有率が(A3-I) 20モル%、(A3-II) 10モル%、(A3-III)35モル%、(A3-IV)35モル% であり、Mwが13,000の共重合体を収率70%で 得た。この共重合体を、共重合体(A-3)とする。

[0128]

【化58】

## 【0129】合成例4

仕込み原料として、2-(5'-ヒドロキシビシクロ[2.2.1]ペプチル)アクリレート40部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート10部、8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1'.'3.1''10]ドデカー3-エン35部、無水マレイン酸15部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1\*

\* と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が (A4-I) 40モル%、(A4-II)10モル%、(A4-III)25モル%、(A4-IV)25モル%であり、Mwが10,00の共重合体を収率64%で得た。この共重合体を、共重合体(A-4)とする。

[0130] (化59]

## 【0131】合成例5

仕込み原料として、3-(8'-EFロキシテトラシクロ[4.4.0.1².5.17.10]ドデシル)アクリレート30部、2-メチルー2-アダマンチルアクリレート12部、5-tーブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]へプトー2-エン38部、無水マレイン酸20部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と同様に%

※して、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(AS-I)2 0モル%、(AS-II)10モル%、(AS-III)35モル%、 (AS-IV)35モル%であり、Mwが12,000の共重 合体を収率67%で得た。この共重合体を、共重合体 (A-S)とする。

[0132] [化60]

### 【0133】合成例6

仕込み原料として、3-(8'-ヒドロキシテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2.5</sup>.1<sup>7.10</sup>]ドデシル)アクリレート50部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート10部、8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2.5</sup>.1<sup>7.10</sup>]ドデカ-3-エン30部、無水マレイン酸10部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以\*

57

\* 外は、合成例1 と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A6-I)40モル%、(A6-II)10モル%、(A6-II)25モル%であり、Mwが8,000の共重合体を収率58%で得た。この共重合体を、共重合体(A-6)とする。

[0134] [(k61]

(A6-II)

#### 【0135】合成例7

仕込み原料として、3-(8'-ヒドロキシテトラシクロ[4.4.0.1'.'.1'']ドデシル)アクリレート50部、2-エチル-2-アダマンチルアクリレート10部、8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1'.'.1']ドデカ-3-エン30部、無水マレイン酸10部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以※

(A6-I)

(A6-III) (A6-IV)

※外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A7-I) 40モル%、(A7-II)10モル%、(A7-III)25モル%、(A7-IV)25モル%であり、Mwが8,000の共重合体を収率58%で得た。この共重合体を、共重合体(A-7)とする。

[0136] [(62]

### 【0137】合成例8

仕込み原料として、4-オキソー1-アダマンチルアクリレート27部、2-メチルー2-アダマンチルメタクリレート13部、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]へプト-2-エン40部、無水マレイン酸20部、アゾビスイソブチロニトリル10部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と

同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A8-I) 20モル%、(A8-II)10モル%、(A8-III)35モル%、(A8-IV)35モル%であり、Mwが12、000の共重合体を収率67%で得た。この共重合体を、共重合体(A-8)とする。

[0138]

【化63】

#### 【0139】合成例9

仕込み原料として、3-(8.-ヒドロキシテトラシク ロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデシル) アクリレ ート30部、(1-アダマンチル-1-メチルエチル) アクリレート16部、5-t-ブトキシカルボニルビシ クロ[2.2.1]ヘプト-2-エン38部、無水マレ イン酸20部、アゾビスイソブチロニトリル10部およ びテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例\* \*1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が (A9-I) 20モル%、(A9-II) 10モル%、(A9-III) 3 5モル%、(A9-IV) 3 5モル%であり、Mwが12.0 00の共重合体を収率67%で得た。この共重合体を、 共重合体(A-9)とする。

[0140] 【化64】

(A9-II)

# 【0141】合成例10

仕込み原料として、3-(8'-ヒドロキシテトラシク ロ[4.4.0.12.5.17.10]ドデシル) アクリレ ート50部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレ ート35部、β-アクリロイルオキシ-γ-ブチロラク トン15部、アゾピスイソブチロニトリル5部およびテ トラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と 同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A1 0-I)50モル%、(A10-II)30モル%、(A10-III)20 モル%であり、Mwが9,000の共重合体を収率67 %で得た。この共重合体を、共重合体 (A-10)とする。 [0142]

(A9-I)

【化65】

(A9-III) (A9-IV)

(A10-I)(A10-II)

【0143】合成例11

仕込み原料として、3-ヒドロキシ-1-アダマンチル アクリレート25部、4-ヒドロキシシクロヘキシルア クリレート50部、2-メチル-2-アダマンチルメタ クリレート25部、アゾビスイソブチロニトリル5部お よびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成 50 例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率

(A10-III)

が (A11-I) 2 0 モル%、(A11-II) 6 0 モル%、(A11-II I) 2 0 モル%であり、Mwが9,000の共重合体を収率67%で得た。この共重合体を、共重合体(A-11)とする。

61

[0144] [化66]

(A11-II) (A11-III)

\*【0145】合成例12

仕込み原料として、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート30部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート45部、α-メタクリロイルオキシーγーブチロラクトン25部、アゾビスイソブチロニトリル5部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含有率が(A12-I)30モル%、(A12-II)40モル%、(A12-III)30モル%であり、Mwが8,500の共重10合体を収率70%で得た。この共重合体を、共重合体

(A-12)とする。 【O 1 4 6 】 【化6 7 】

## 【0147】合成例13

仕込み原料として、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート30部、2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート45部、β-アクリロイルオキシ-γ-ブチロラクトン25部、アゾビスイソブチロニトリル5部およびテトラヒドロフラン100部を用いた以外は、合成例1と同様にして、下記式に示す各繰返し単位の含※

※有率が(A13-I)30モル%、(A13-II)40モル%、(A13-III)30モル%であり、Mwが8,900の共重合体30 を収率72%で得た。この共重合体を、共重合体(A-13)とする。

[0148] [化68]

### 【0149】比較重合例1

アクリル酸テトラヒドロピラニル18.28部、アクリル酸トリシクロデカニル25部、アゾイソブチロニトリル0.2部およびtードデシルメルカプタン0.1部を1,2-ジェトキシェタン100部に溶解し、65℃で5時間重合した。重合終了後、反応溶液を大量のメチル 50

アルコール中に注いで、樹脂を凝固させ、凝固した樹脂を減圧乾燥して、アクリル酸テトラヒドロピラニルおよびアクリル酸トリシクロデカニルの各含有率がともに50モル%であり、Mwが20,000の共重合体を収率35%で得た。この共重合体を、樹脂(a-1)とする。【0150】

【実施例】実施例1~18、比較例1

表1に示す成分を混合して均一溶液としたのち、孔径 0.2 μ mのメンブランフィルターでろ過して、各組成 物溶液を調製し、各種評価を行った。評価結果を、表3 に示す。各実施例および比較例中の樹脂以外の成分は、 下記のとおりである。酸発生剤(B)

B-1: トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート

B-2: トリフェニルスルホニウムノナフルオローn - ブタンスルホネート

,,,

\*ナフルオローn-ブタンスルホネート

B-5:トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボジイミド酸拡散制御剤

64

C-1: トリーn-オクチルアミン

C-2: メチルジシクロヘキシルアミン

C-3:1-(2'-ヒドロキシエチル)ピペラジン

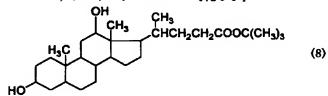
C-4:4-ヒドロキシキノリン

他の添加剤

10 D-1: デオキシコール酸 t - ブチル (下記式 (8) 参照)

[0151]

【化69】



【0152】D-2:1、3-アダマンタンジカルボン酸 20 ート

ジーt-ブチル溶剤

E-1:2-ヘプタノン

E-2:2-ヒドロキシプロピオン酸エチル

E-3: プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテ

E-4:3-エトキシプロピオン酸エチル

E-5:シクロヘキサノン

[0153]

【表 1.]

03	_ <u>表 1</u>						
	樹脂	酸発生剤 (B) (部)	酸拡散制御利 (部)	他の添加剤(節)	溶 剤 (部)		
実施例1	A-1 ( 95)	B-2 (1,5)	C-2 (0.03)	D-1 (5)	E-1 (480)		
実施例2	A-1 (100)	B-1 (1.5)	C-1 (0.03)		E-1 (480)		
実施例3	A-2 ( 95)	B-1 (1.5)	C-2 (0, 03)	D-1 (5)	E-2 (480)		
実施例4	A-2 ( 95)	B-1 (0,5) B-2 (L0)	C-1 (0,01) C-4 (0,01)	D-1 (5)	E-2 (420) E-4 (100)		
実施例 5	A-3 (100)	B-2 (1,5)	C-3 (0, 03)	_	E-3 (480)		
実施例 6	A-3 (95)	B-3 (L 5) B-5 (0, 5)	C-1 (0, 03)	D-1 (5)	E-1 (480)		
実施例7	A-4 ( 95)	B-3 (L5)	C-4 (0, 03)	D-1 (5)	E-2 (420) E-4 (100)		
実施例8	A-4 ( 95)	B-2 (1.0) B-3 (1.0)	C-2 (0, 03)	D-2 (5)	E-1 (480)		
実施例9	A-5 (95)	B-4 (1.5)	C-1 (0, 03)	D-1 (5)	E-1 (530)		
実施例10	A-5 (95)	B-2 (1,5)	C-2 (0.03)	D-2 (5)	E-1 (530)		
実施例11	A-6 (100)	B-1 (1.5) B-5 (0.3)	C-1 (0, 03)		E-1 (530)		
実施例12	A-7 (95)	B-2 (1.5) B-5 (0.3)	C-1 (0, 03)	D-1 (5)	E-1 (300) E-3 (150)		
実施例13	A-8 (95)	B-1 (L5)	C-1 (0.03)	D-1 (5)	E-1 (480)		
実施例14	A-9 ( 90)	B-2 (1, 5)	C-1 (0, 03)	D-1 (10)	E-1 (450)		
実施例15	A-10( 90)	B-4 (L 5)	C-1 (0, 03)	D-2 (10)	E-1 (410)		
実施例18	A-11( 90)	B-4 (1, 5)	C-1 (0, 03)	D-2 (10)	E-1 (410)		
実施例17	A-12( 90)	B-2 (2,0)	C-3 (0.04)	D-1 (10)	E-1 (400) E-5 (100)		
実施例18	A-13( 90)	B-2 (2,0)	C-3 (0, 04)	D-1 (10)	E-1 (400) E-5 (100)		
比較例1	a-l (100)	B-1 (1,5)	C-1 (0, 03)		E-1 (530)		

【0154】 【表2】

表 2

(35)

	レジスト被膜	基板の種類	РВ		PEB	
	の関写(μm)		温度 (℃)	時間(沙)	温度 (°C)	時間 (秒)
実施例1	0.4	ARC	140	90	140	90
実施例2	0, 4	ARC	140	90	140	90
実施例3	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施例4	0. 4	ARC	130	90	140	90
実施例5	0, 4	ARC	130	90	130	90
实施例 6	0.4	ARC	140	90	140	90
実施例7	0. 4	ARC	130	90	130	90
実施例8	0. 4	ARC	130	90	140	90
実施例9	0, 4	ARC	140	90	140	90
実施例10	0.4	ARC	140	90	140	90
実施例11	0, 4	ARC	140	90	140	90
実施例12	0.4	ARC	140	90	140	90
実施例13	0.4	ARC	140	90	140	90
実施例14	0, 4	ARC	140	90	140	90
実施例15	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施例16	0.4	ARC	130	90	140	90
実施例17	0.4	ARC	130	90	130	90
実施例18	0.4	ARC	130	90	130	90
比較例1	0,4	ARC	140	90	140	90

# [0155]

\* \*【表3】

	保存安定性	放射線透透率 (193mm, %)	相対エッチング 速度	(四/四3)	解像度 (μm)	パターン 形状
実施例1	60日以上	65	L.4	16	0. 15	良好
実施例2	60日以上	63	1.5	15	0, 15	良好
実施例3	60日以上	67	1,3	17	0. 15	良好
実施例 4	60日以上	66	1,3	17	Q 15	良好
実施例 5	60日以上	62	1, 6	15	0. 15	良好
実施例 6	60日以上	64	1.6	15	Q 15	良好
実施例7	60日以上	64	1.4	16	Q 15	良好
実施例8	60日以上	64	1,4	17	0, 15	良好
実施例 9	60日以上	62	1.6	15	0, 15	良好
実施例10	60日以上	62	L5	17	Q. 15	良好
実施例11	60日以上	65	1.2	16	0. 15	良好
実施例12	60日以上	65	1.2	16	0, 15	良好
実施例13	60日以上	63	1.5	17	0. 15	良好
実施例14	60日以上	64	1, 4	18	Q 15	良好
実施例15	60日以上	70	1. 4	16	0, 15	良好
実施例16	60日以上	70	1, 5	15	0. 15	良好
実施例17	60日以上	71	1. 5	13	0, 15	段好
実施例18	60日以上	71	1, 5	14	0, 15	良好
比較例1	10日	70	2.5	13	0, 25	不良

増幅型レジストとして、組成物としての保存安定性が優れ、かつ放射線に対する透明性が高く、しかもドライエッチング耐性、感度、解像度、パターン形状等のレジス\*

69

\*トとしての基本物性に優れており、今後さらに微細化が 進行すると予想される半導体デバイスの製造に極めて好 適に使用することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 梶田 徹

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 下川 努

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA09 AC04

AC05 AC06 AC08 AD03 BE00

BG00 FA03 FA12 FA17

4J002 BG041 BG051 BG071 BK001

EB006 EB126 EQ016 EU046

EU186 EV216 EV246 EV266

EV296 EV306 EW176 EY006

FD206 GP03